

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

西安奕斯伟材料科技股份有限公司
投资者活动记录表

编号：2026-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（投资者线上交流）
参与单位名称及参会人员姓名	Morgan Stanley 邹静、赵思昊、王启明、桂晓芳
会议时间	2026年04月28日 上午
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 杨春雷 首席市场官 柳清超 证券事务代表 赵润欣 董秘办 索子欣、刘晗
会议内容	<p>1、请问目前硅片市场的格局是怎样的？未来的发展如何？</p> <p>答：全球12英寸硅片市场呈现“海外主导、国内追赶”的竞争格局，行业具有技术密集、资本密集、研发与认证周期长等特点，长期由日本信越化学、SUMCO及中国台湾环球晶圆等海外企业主导，当前全球供应占比仍达70%以上。近年来国内企业正加快技术突破与产能建设，市场份额逐步提升，国产替代持续深入。</p> <p>2022-2024年，全球半导体行业经历周期性调整，市场景气度承压。2025年全球半导体行业迎来结构性复苏，AI、数据中心等应用对算力及存储领域需求的增长成为驱动行业增长的核心引擎，传统应用需求逐步复苏，库存持续调整，行业整体处于筑底调整与动能积蓄阶段，以AI为代表的新兴产业，为硅片行业带来新机遇。</p> <p>2、公司海外客户占比如何？未来目标是怎样的？公司目前的技术水平跟海外厂商技术相比如何，有什么差异？</p> <p>答：公司设立之初就制定了立足国内，更放眼全球客户的市场策略，2025年公司海外业务占整体业务的25%以上，提升海外客户供应份额将持续作为公司后续市场开拓的重点工作之一。在抛光片领域，随着国内存储晶圆厂商的崛起，当前用于存储芯片制造的12英寸抛光片国产化比例较高，国内硅片企业已实现规模化量产供应，与客户协同技术研发、具备一定的产能规模、稳定的量产品品质保障及提升海外头部存储芯片厂商</p>

供应份额是国内企业面临的主要挑战；在用于逻辑芯片的 12 英寸外延片领域，海外硅片厂商在高端产品占据主导，海外头部企业已实现 2nm 制程量产，较高的技术壁垒与客户认证周期，仍是国内企业实现突破的核心挑战。未来，国内企业需持续聚焦高端产品以及多元化产品的技术突破与产业链协同，力争在产品丰富度及产品品质上全面追赶，从而逐步缩小与国际先进水平的差距。

3、公司怎么看待硅片未来的增长趋势？

答：从行业周期看，硅片行业与全球半导体市场波动同频，短期虽有起伏，但长期趋势向好，硅片行业已进入 AI、数据中心等新应用及芯片异构集成技术双轮驱动周期。据 SEMI 预测，2026 年全球 12 英寸晶圆厂量产数量预计达 215 座，其中中国大陆将达到 70 座。全球芯片厂持续扩产，将持续推升 12 英寸硅片需求。据 SEMI 预测，2025 年全球硅片出货面积将同比增长 5.8% 至 12,973 百万平方英寸，并预计在 2026 年达到约 13,488 百万平方英寸。12 英寸硅片系硅片市场主流，据 SEMI 预测，12 英寸硅片约贡献了 2025 年全球所有规格硅片出货面积的 78.8%。2025 年全球 12 英寸硅片出货面积预计达到约 10,117 百万平方英寸，同比增长 8.8%，2026 年出货面积将进一步攀升至约 10,649 百万平方英寸，同比增长 5.3%，增速显著高于行业平均水平，市场份额将进一步提升至接近 80%。

4、公司客户端未来规划及增长如何？公司现在先进制程的外延片进展如何？公司的未来规划中，在先进制程产品中想要达到怎样的占比？

答：据 SEMI 预测，2026 年全球 12 英寸晶圆厂量产数量预计达 215 座，其中中国大陆将达到 70 座。凭借优异的产品品质与稳定的供应能力，公司立足国内，更放眼全球，已构建起覆盖海内外主流晶圆厂商的客户体系。目前，公司系国内头部存储芯片厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商、国内头部晶圆代工厂中国大陆 12 英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商。公司在立足国内市场的同时，持续服务全球客户。公司根据市场需求和客户规划稳步推进产能扩产及技术品质能力提升，并不断优化产品结构，随着公司第二工厂达产，2026 年 12 月公司将具备约 120 万片/月产能，预计第三工厂达产后公司将具备约 180 万片/月产能。

5、请问 AI 芯片从硅片的角度上看，技术有什么区别？功率器件和 Power MOSFET 等特色工艺的产品目前进展情况如何？

答：AI 芯片主要包括算力、存力及控制芯片等半导体器件，更强的数据算力、更快的数据传输、更大的数据存储和更灵敏的人机交互是 AI 时代的刚需，而用于实现前述功能的市场最主流逻辑和存储芯片（一般 90nm 工艺制程以下）以及部分高端模拟和传感器芯片均采用 12 英寸晶圆制造工艺，12 英寸晶圆产能是全球晶圆厂扩产的主流方向，作为核心衬底材料，未来 12 英寸硅片全球出货面积占比将持续提升。

作为 12 英寸电子级硅片细分赛道领域的 N 型硅片，市场规模占比约 10%，主要采用磷等元素进行掺杂，其对电阻率、氧含量、缺陷密度等指标具备差异化要求。用于 IGBT

器件的 N 型轻掺抛光片产品，公司已布局该细分领域，2025 年相关产品已开发完成并通过下游客户验证；用于 Power MOSFET 器件的 N 型重掺外延片产品，公司已布局该细分领域，2025 年相关产品已开发完成，正在推进客户送样工作。

6、公司第三工厂的产能规划是怎样的？目前第一工厂产能已经超过了规划产能 50 万片，处于 65 万片/月，未来是否还有提升空间？三工厂未来是否也会达到一工厂的产能水平？

答：公司第三工厂规划产能为 50 万片/约产能，目前处于建设阶段，预计 2027 年上半年实现首批产能投产，预计 2030 年达产。公司在生产过程中不断优化工艺技术，通过自动化、智能化等方式提升生产效率，截至 2025 年 12 月，公司第一工厂已达到 65 万片/月产能，产能提升经验具备复用性，后续新工厂预计可达到同等产能规模。

7、公司扭亏为盈的时间点预期是怎样的？

答：考虑产能规模、产品结构、客户需求及市场情况等因素，预计 2027 年公司将实现合并报表盈利。